

# 2019年3月期 決算説明会

株式会社フジミインコーポレーテッド

2019年5月17日

# 1. 決算概要

## 【業績】

- ✓ 売上高 4.5%増 : 年明け以降は半導体生産調整の影響を受けるも、半導体（シリコンウェハー、ロジック・メモリデバイス）好調
- ✓ 営業利益 9.0%増 : 半導体好調、製品ミックスの良化
- ✓ 当期純利益 41.7%増 : 日米での法人税率低減もあり、過去最高を更新
- ✓ CMP向け : 半導体好調により4期連続で過去最高売上高を更新
- ✓ シリコンウェハー向け : 半導体好調、ポリシング新規採用により増収
- ✓ ハードディスク向け : 顧客統合によるプロセス変更に伴う使用量減等により減収
- ✓ 一般工業用向け : (研磨材) LED用サファイア基板、研磨布紙向けで減収  
(非研磨材)半導体・FPD製造装置向け好調で増収

# 業績概要 (通期実績)

単位：百万円	18年3月期	19年3月期					
	通期実績	期初予想 ('18/5)	修正予想 ('18/11)	通期実績	前年比	期初 ('18/5) 予想比	修正 ('18/11) 予想比
売上高	35,788	36,500	37,500	37,394	+4.5%	+2.4%	△0.3%
営業利益	4,872	5,100	5,300	5,310	+9.0%	+4.1%	+0.2%
営業利益率	13.6%	14.0%	14.1%	14.2%	-	-	-
経常利益	4,728	5,200	5,600	5,637	+19.2%	+8.4%	+0.7%
経常利益率	13.2%	14.2%	14.9%	15.1%	-	-	-
当期純利益	3,011	3,900	4,200	4,265	+41.7%	+9.4%	+1.6%
当期純利益率	8.4%	10.7%	11.2%	11.4%	-	-	-

(前期比) ・半導体市場好調により、増収増益  
 ・当期純利益は過去最高を更新

# 業績概要 (半期実績)

単位：百万円	18年3月期		19年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	上期比
売上高	17,417	18,371	19,163	+10.0%	+4.3%	18,231	△0.8%	△4.9%
営業利益	2,289	2,583	2,813	+22.9%	+8.9%	2,497	△3.3%	△11.2%
営業利益率	13.1%	14.1%	14.7%	-	-	13.7%	-	-
経常利益	2,250	2,478	3,056	+35.8%	+23.3%	2,580	+4.1%	△15.6%
経常利益率	12.9%	13.5%	15.9%	-	-	14.2%	-	-
当期純利益	1,647	1,364	2,339	+42.0%	+71.5%	1,926	+41.2%	△17.7%
当期純利益率	9.4%	7.4%	12.2%	-	-	10.6%	-	-

・19/3期の半導体市場が秋口以降、減速傾向を強めたことに伴い、下期業績は上期を下回った

# 業績予想 (通期)

単位：百万円	18年3月期	19年3月期	20年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	35,788	37,394	37,500	+0.3%
営業利益	4,872	5,310	4,700	△11.5%
営業利益率	13.6%	14.2%	12.5%	-
経常利益	4,728	5,637	4,800	△14.8%
経常利益率	13.2%	15.1%	12.8%	-
当期純利益	3,011	4,265	3,600	△15.6%
当期純利益率	8.4%	11.4%	9.6%	-

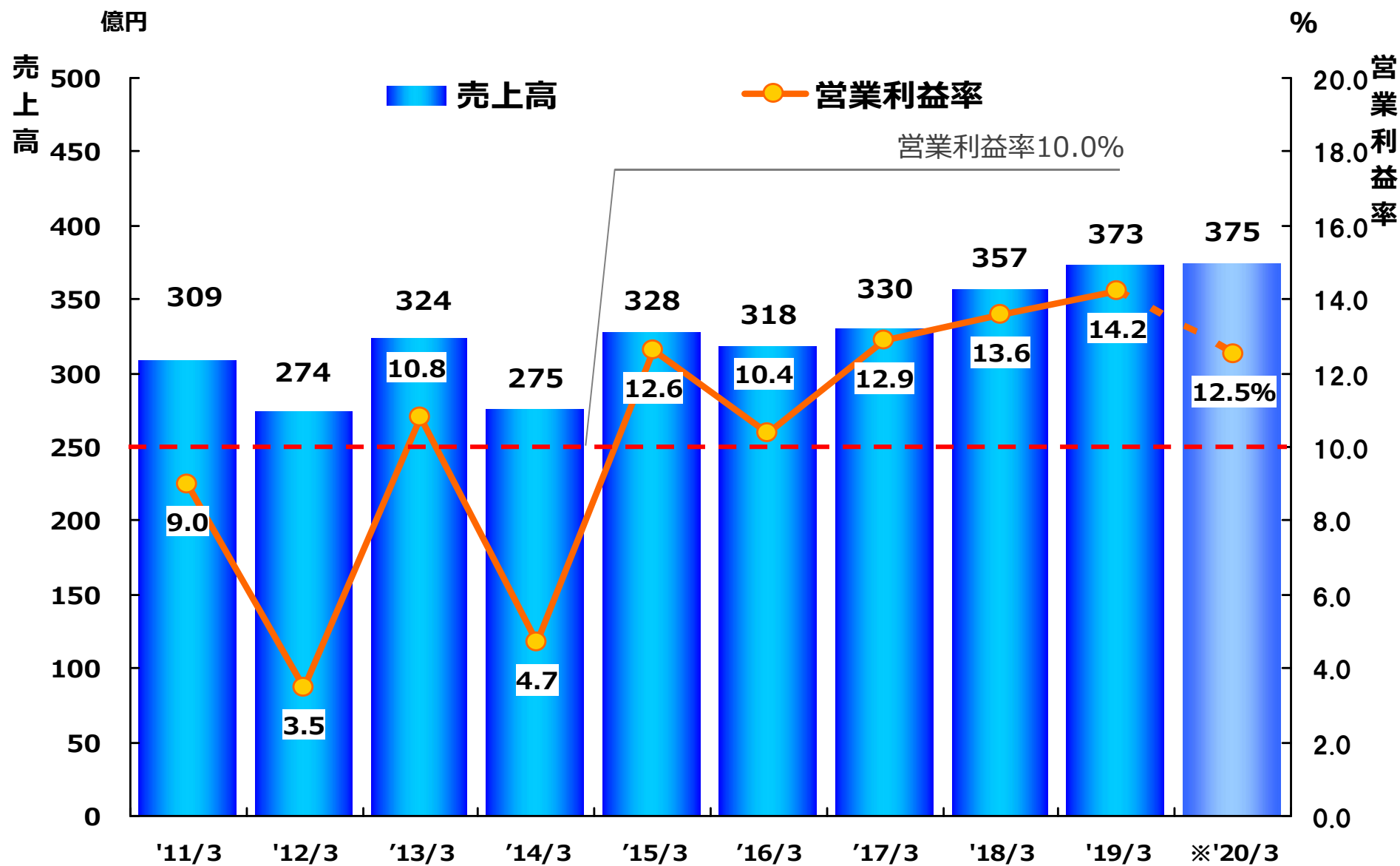
・売上高は前期並みを見込むも、新たな成長に資する取組みのための先行投資費用の増加により減益を見込む（想定為替レート：110円/ドル）

# 業績予想 (半期)

単位：百万円	19年3月期		20年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	上期比
売上高	19,163	18,231	18,000	△6.1%	△1.3%	19,500	+7.0%	+8.3%
営業利益	2,813	2,497	2,000	△28.9%	△19.9%	2,700	+8.1%	+35.0%
営業利益率	14.7%	13.7%	11.1%	-	-	13.8%	-	-
経常利益	3,056	2,580	2,050	△32.9%	△20.5%	2,750	+6.6%	+34.1%
経常利益率	15.9%	14.2%	11.4%	-	-	14.1%	-	-
当期純利益	2,339	1,926	1,550	△33.8%	△19.5%	2,050	+6.4%	+32.3%
当期純利益率	12.2%	10.6%	8.6%	-	-	10.5%	-	-

- ・半導体市場について、年末まで在庫消化による生産調整が続き、本格回復は年明け以降を想定
- ・前年同期比で、上期は減収減益となるも、下期は半導体分野での新規採用に加え、年明け以降の半導体市場回復により業績回復を見込む

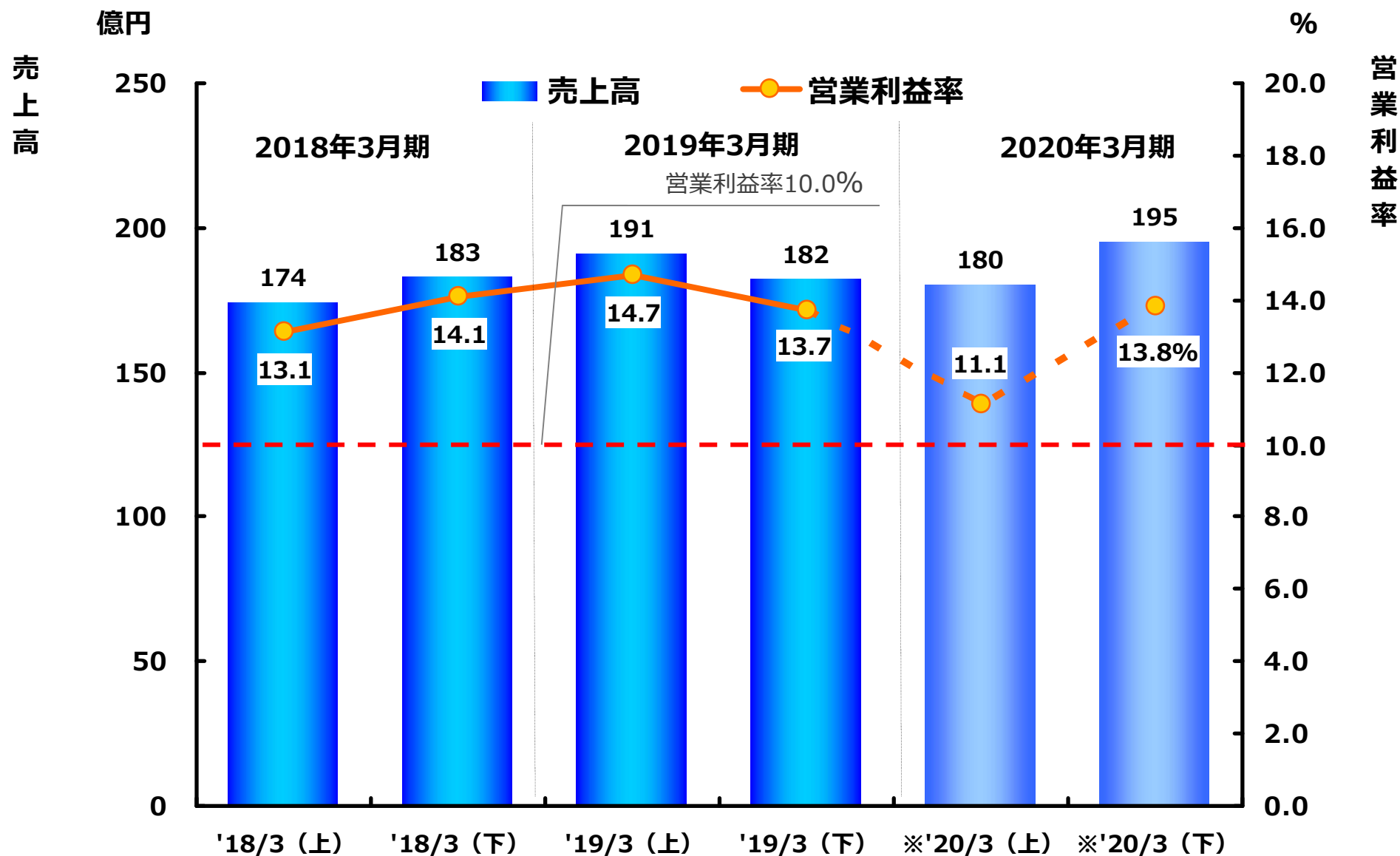
# 業績推移 (通期)



※'20/3は予想



# 業績推移 (半期)



※'20/3 (上) (下) は予想

## 2. 用途別売上高

# 用途別売上高 (通期実績)

単位：百万円		18年3月期	19年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	3,588	4,297	+19.8%
	ポリシング	7,472	8,621	+15.4%
	切断	535	453	△15.2%
	計	11,596	13,373	+15.3%
CMP		14,621	15,305	+4.7%
ディスク	アルミディスク	2,694	2,171	△19.4%
	ガラスディスク	542	96	△82.2%
	計	3,236	2,268	△29.9%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	4,244	3,931	△7.4%
	一般工業用(非研磨材)	1,904	2,121	+11.4%
	計	6,149	6,053	△1.6%
製品売上高		35,603	36,999	+3.9%
商品売上高		185	395	+113.5%
売上高 合計		35,788	37,394	+4.5%

# 用途別売上高 (半期実績)

単位：百万円		18年3月期		19年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハー	ラッピング	1,735	1,852	2,176	+25.4%	+17.5%	2,120	+14.5%	△2.6%
	ポリシング	3,392	4,080	4,301	+26.8%	+5.4%	4,319	+5.9%	+0.4%
	切断	274	260	228	△16.8%	△12.3%	225	△13.5%	△1.1%
	計	5,402	6,193	6,706	+24.1%	+8.3%	6,666	+7.6%	△0.6%
CMP		7,200	7,420	7,690	+6.8%	+3.6%	7,614	+2.6%	△1.0%
ディスク	アルミディスク	1,408	1,285	1,225	△13.0%	△4.7%	946	△26.4%	△22.8%
	ガラスディスク	311	231	51	△83.6%	△77.9%	45	△80.5%	△11.5%
	計	1,719	1,517	1,276	△25.8%	△15.9%	991	△34.7%	△22.4%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	2,116	2,128	2,212	+4.5%	+3.9%	1,718	△19.3%	△22.3%
	一般工業用(非研磨材)	890	1,013	1,070	+20.2%	+5.6%	1,051	+3.7%	△1.8%
	計	3,007	3,142	3,283	+9.2%	+4.5%	2,769	△11.9%	△15.6%
製品売上高		17,329	18,273	18,957	+9.4%	+3.7%	18,042	△1.3%	△4.8%
商品売上高		87	97	206	+136.8%	+112.4%	189	+94.6%	△8.2%
売上高 合計		17,417	18,371	19,163	+10.0%	+4.3%	18,231	△0.8%	△4.9%

# 用途別売上高 (通期予想)

単位：百万円		18年3月期	19年3月期	20年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	3,588	4,297	4,700	+9.4%
	ポリシング	7,472	8,621	9,200	+6.7%
	切断	535	453	300	△33.9%
	計	11,596	13,373	14,200	+6.2%
CMP		14,621	15,305	14,800	△3.3%
ディスク	アルミディスク	2,694	2,171	1,900	△12.5%
	ガラスディスク	542	96	100	+4.0%
	計	3,236	2,268	2,000	△11.8%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	4,244	3,931	4,000	+1.8%
	一般工業用(非研磨材)	1,904	2,121	2,200	+3.7%
	計	6,149	6,053	6,200	+2.4%
製品売上高		35,603	36,999	37,200	+0.5%
商品売上高		185	395	300	△24.1%
売上高 合計		35,788	37,394	37,500	+0.3%

# 用途別売上高 (半期予想)

単位：百万円		19年3月期		20年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハー	ラッピング	2,176	2,120	2,300	+5.7%	+8.4%	2,400	+13.2%	+4.3%
	ポリシング	4,301	4,319	4,350	+1.1%	+0.7%	4,850	+12.3%	+11.5%
	切断	228	225	150	△34.3%	△33.5%	150	△33.5%	+0.0%
	計	6,706	6,666	6,800	+1.4%	+2.0%	7,400	+11.0%	+8.8%
CMP		7,690	7,614	7,200	△6.4%	△5.4%	7,600	△0.2%	+5.6%
ディスク	アルミディスク	1,225	946	830	△32.3%	△12.2%	1,070	+13.1%	+28.9%
	ガラスディスク	51	45	70	+37.1%	+54.9%	30	△33.4%	△57.0%
	計	1,276	991	900	△29.5%	△9.2%	1,100	+11.0%	+22.2%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	2,212	1,718	1,950	△11.8%	+13.5%	2,050	+19.3%	+5.1%
	一般工業用(非研磨材)	1,070	1,051	1,000	△6.6%	△4.9%	1,200	+14.2%	+20.0%
	計	3,283	2,769	2,950	△10.1%	+6.5%	3,250	+17.4%	+10.2%
製品売上高		18,957	18,042	17,850	△5.8%	△1.1%	19,350	+7.3%	+8.4%
商品売上高		206	189	150	△27.2%	△20.7%	150	△20.7%	+0.0%
売上高 合計		19,163	18,231	18,000	△6.1%	△1.3%	19,500	+7.0%	+8.3%

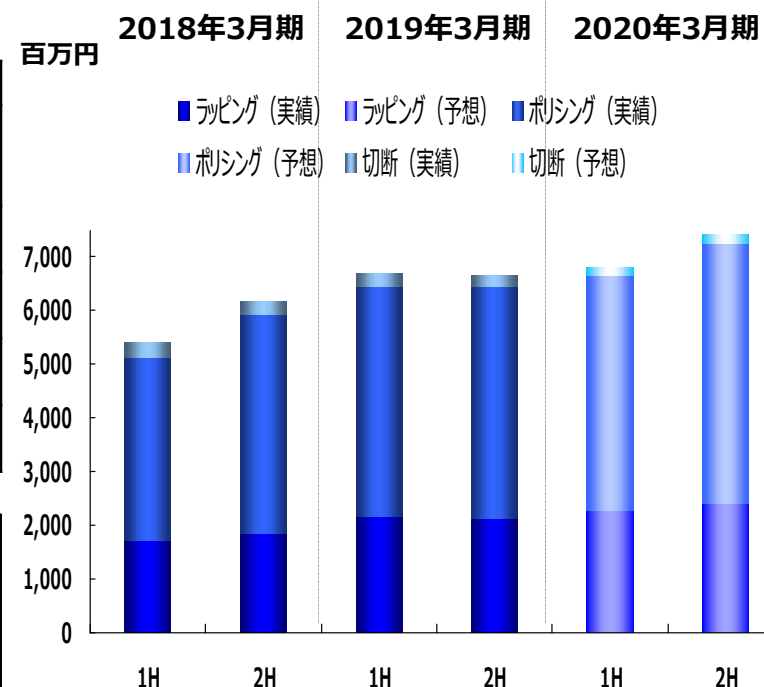
# シリコンウエハー売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

## <<通期>>

単位：百万円		18年3月期	19年3月期		20年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	3,588	4,297	+19.8%	4,700	+9.4%
	ポリシング	7,472	8,621	+15.4%	9,200	+6.7%
	切断	535	453	△15.2%	300	△33.9%
	計	11,596	13,373	+15.3%	14,200	+6.2%

## <<半期>>

単位：百万円		18年3月期		19年3月期		20年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコンウエハー	ラッピング	1,735	1,852	2,176	2,120	2,300	2,400
	ポリシング	3,392	4,080	4,301	4,319	4,350	4,850
	切断	274	260	228	225	150	150
	計	5,402	6,193	6,706	6,666	6,800	7,400



(19/3) 半導体市場の好調とポリシング材の新規採用で増収  
 (20/3) ラッピング 原材料高騰に伴う销售价格見直し  
 ポリシング 下期以降、更なる新規採用で増収を予想

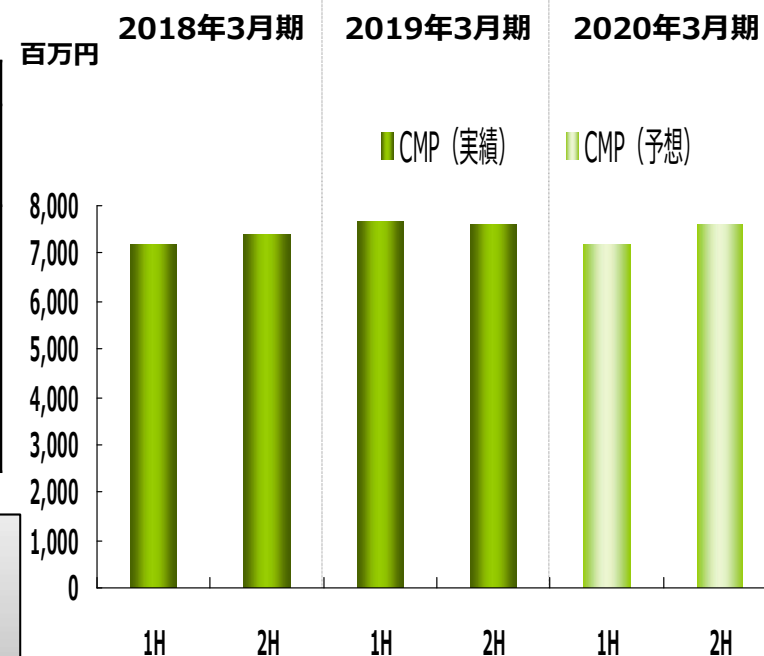
# CMP売上高 (通期実績・予想、半期実績・予想)

## <<通期>>

単位：百万円	18年3月期	19年3月期		20年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
CMP	14,621	15,305	+4.7%	14,800	△3.3%

## <<半期>>

単位：百万円	18年3月期		19年3月期		20年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	7,200	7,420	7,690	7,614	7,200	7,600



(19/3) 最先端ロジック・メモリデバイス向け製品が好調で増収  
 (20/3) 半導体市場の在庫調整により減収を予想 但し、最先端ロジックデバイス立上げにより下期は売上回復見込



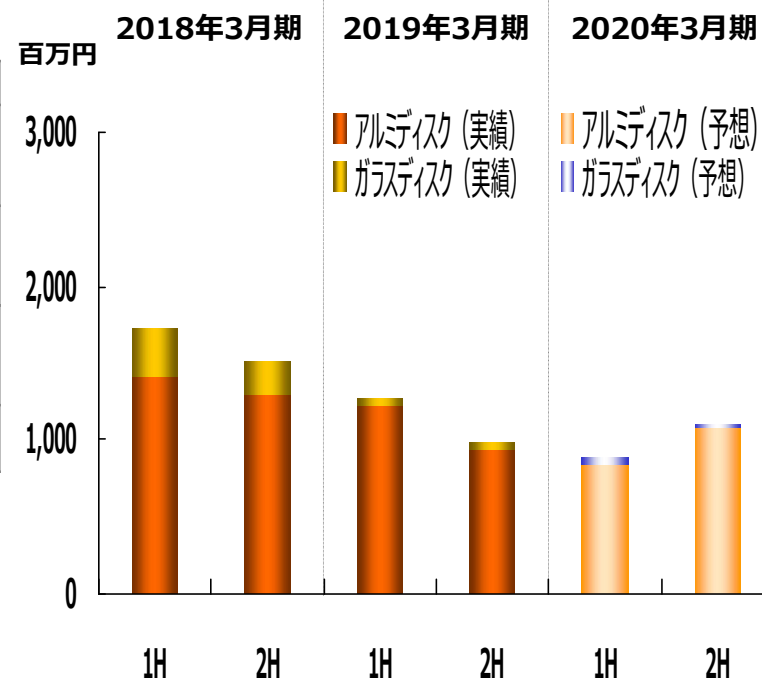
# ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

## ＜＜通期＞＞

単位：百万円		18年3月期	19年3月期		20年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
ディスク	アルミディスク	2,694	2,171	△19.4%	1,900	△12.5%
	ガラスディスク	542	96	△82.2%	100	+4.0%
	計	3,236	2,268	△29.9%	2,000	△11.8%

## ＜＜半期＞＞

単位：百万円		18年3月期		19年3月期		20年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	1,408	1,285	1,225	946	830	1,070
	ガラスディスク	311	231	51	45	70	30
	計	1,719	1,517	1,276	991	900	1,100



(19/3) 市場縮小と顧客の生産プロセス変更の影響により減収  
(20/3) SSDへの切替えに伴うHDD市場縮小の影響により減収を予想

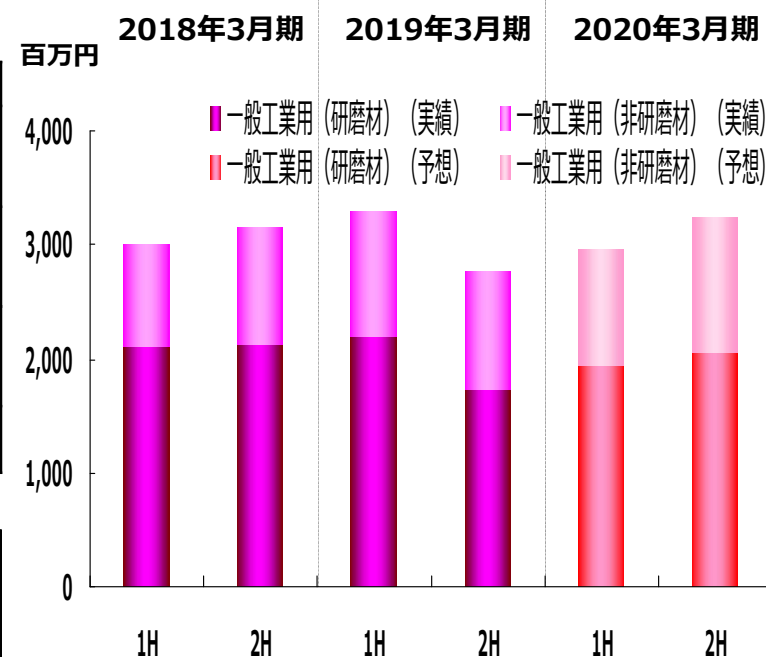
# 機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

## <<通期>>

単位：百万円		18年3月期	19年3月期		20年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	4,244	3,931	△7.4%	4,000	+1.8%
	一般工業用（非研磨材）	1,904	2,121	+11.4%	2,200	+3.7%
	計	6,149	6,053	△1.6%	6,200	+2.4%

## <<半期>>

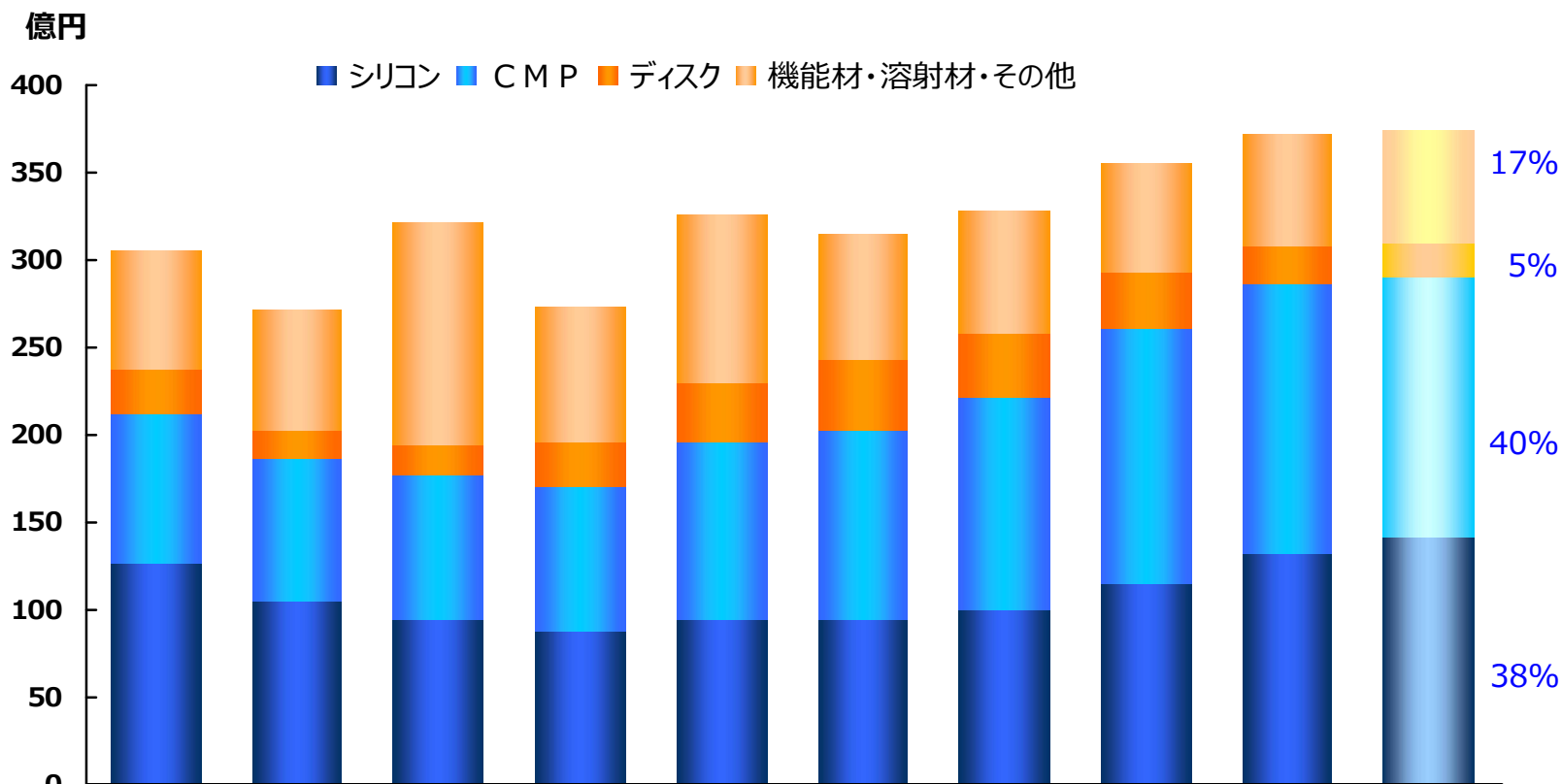
単位：百万円		18年3月期		19年3月期		20年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	2,116	2,128	2,212	1,718	1,950	2,050
	一般工業用（非研磨材）	890	1,013	1,070	1,051	1,000	1,200
	計	3,007	3,142	3,283	2,769	2,950	3,250



【研磨材】（19/3）LED用サファイア基板、研磨布紙向け等で減収  
（20/3）前期並みを予想

【〃以外】（19/3）半導体・FPD製造装置向け好調により増収  
（20/3）半導体・FPD製造装置向けで増収を予想

# 用途別売上高 (通期)

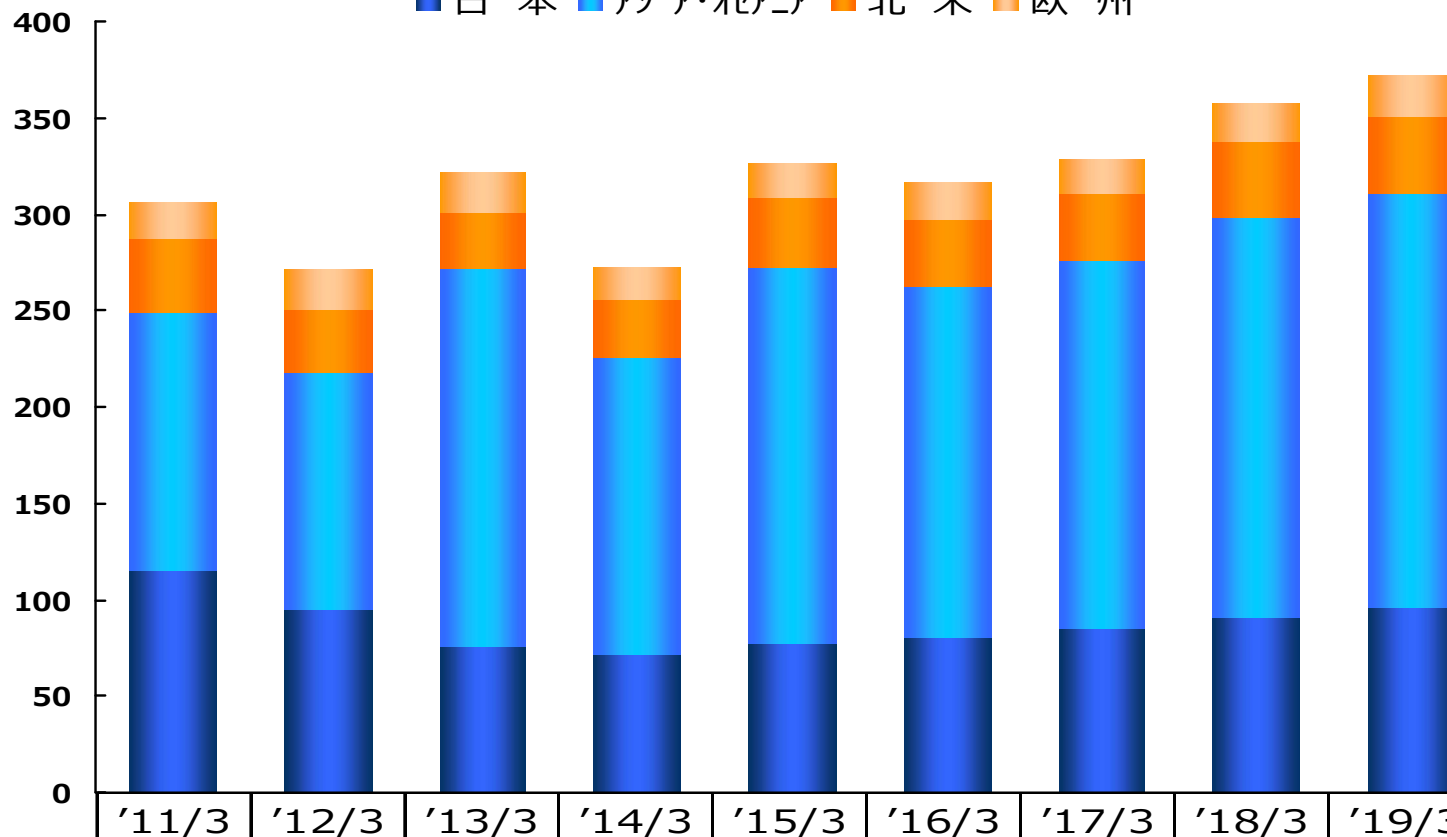


	'11/3	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	'20/3*
機能材・溶射材・その他	68	69	127	77	96	72	70	63	64	65
ディスク	26	17	18	26	34	40	36	32	22	20
CMP	85	80	83	82	101	109	122	146	153	148
シリコン	127	106	94	88	95	94	100	115	133	142
計	308	274	324	274	328	317	330	357	373	375

# 地域別売上高（通期 仕向先別）

億円

■ 日本 ■ アジア・オセアニア ■ 北米 ■ 欧州

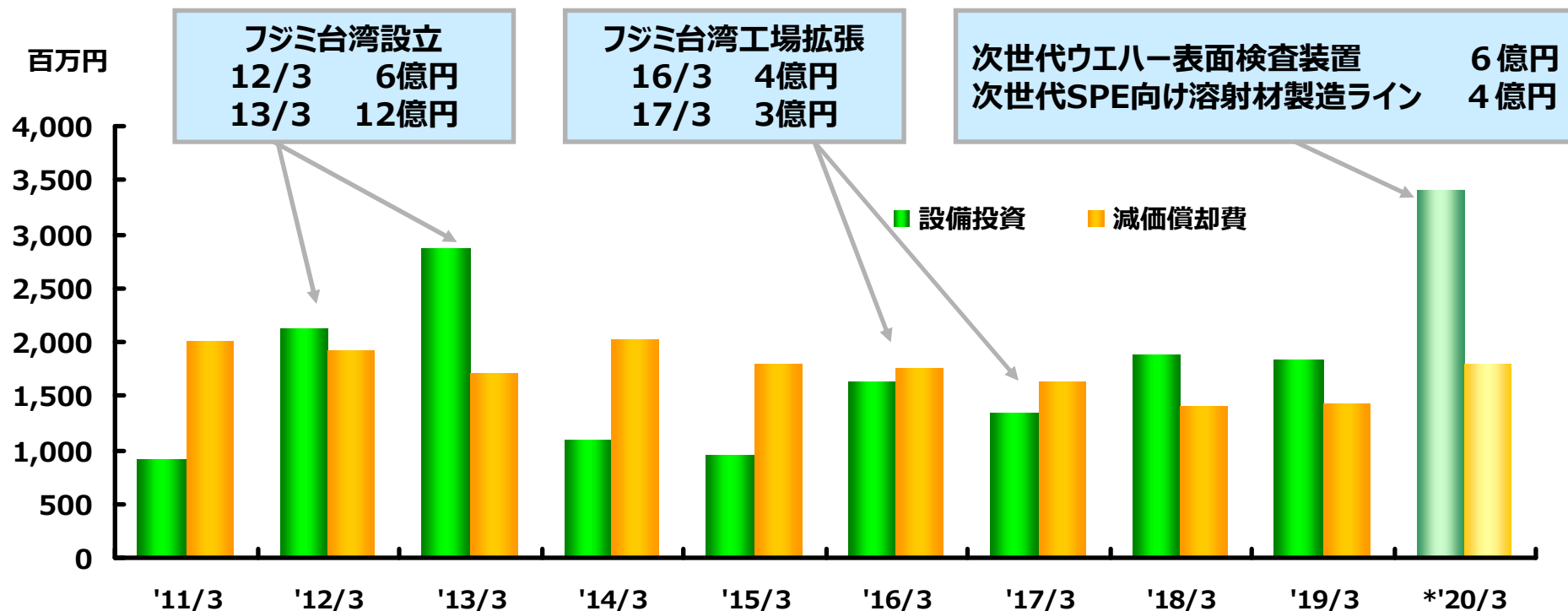


■ 欧州	19	21	21	17	18	19	18	20	21
■ 北米	38	32	30	30	35	34	35	39	40
■ アジア・オセアニア	134	123	195	154	196	182	191	208	215
■ 日本	115	95	76	72	77	81	85	90	96
計	308	274	324	274	328	317	330	357	373

## 3. 設備投資・減価償却費・研究開発費

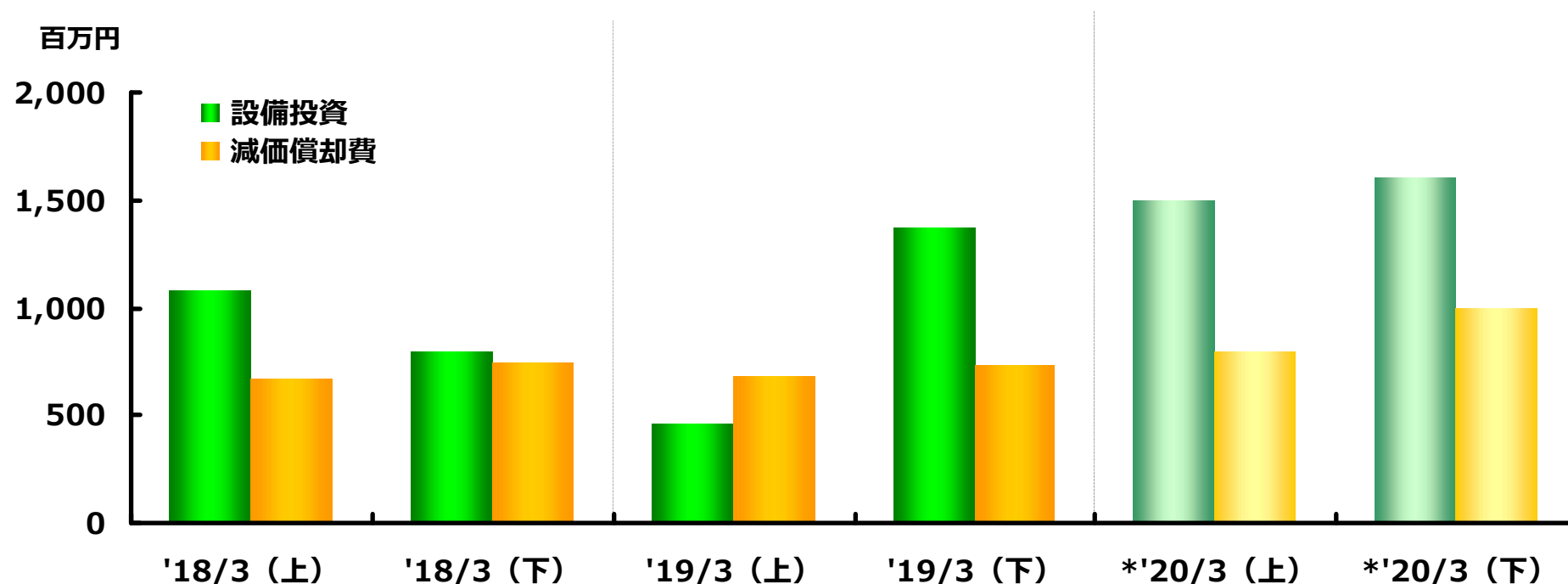
# 設備投資・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円	18年3月期	19年3月期			20年3月期		
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比	通期計画	前年比
設備投資	1,871	2,200	1,829	△2.3%	△16.9%	3,100	+69.5%
減価償却費	1,411	1,400	1,413	+0.1%	+0.9%	1,800	+27.4%



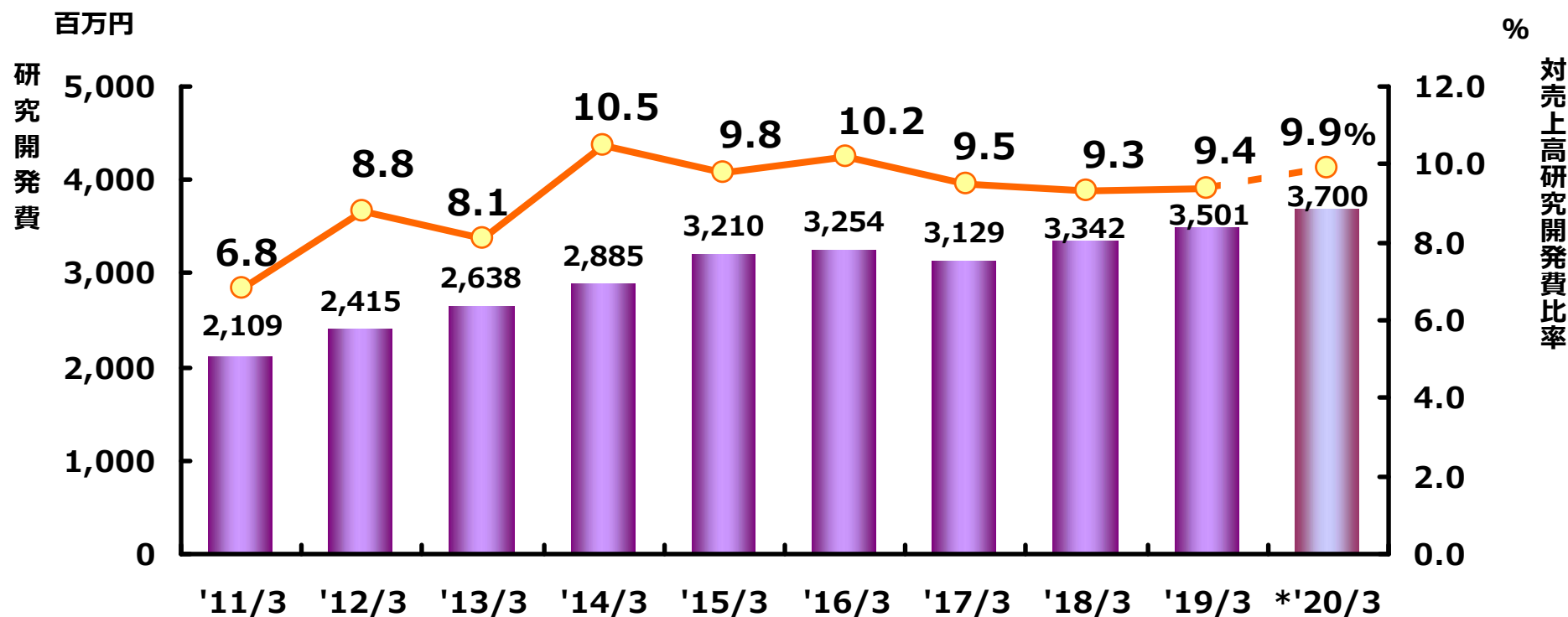
# 設備投資・減価償却費（半期実績・半期計画）

単位：百万円	18年3月期		19年3月期				20期3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	上期比
設備投資	1,083	788	461	1,368	+73.5%	+196.8%	1,500	+225.4%	+9.6%	1,600	+17.0%	+6.7%
減価償却費	665	746	684	729	△2.3%	+6.6%	800	+17.0%	+9.7%	1,000	+37.2%	+25.0%



# 研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

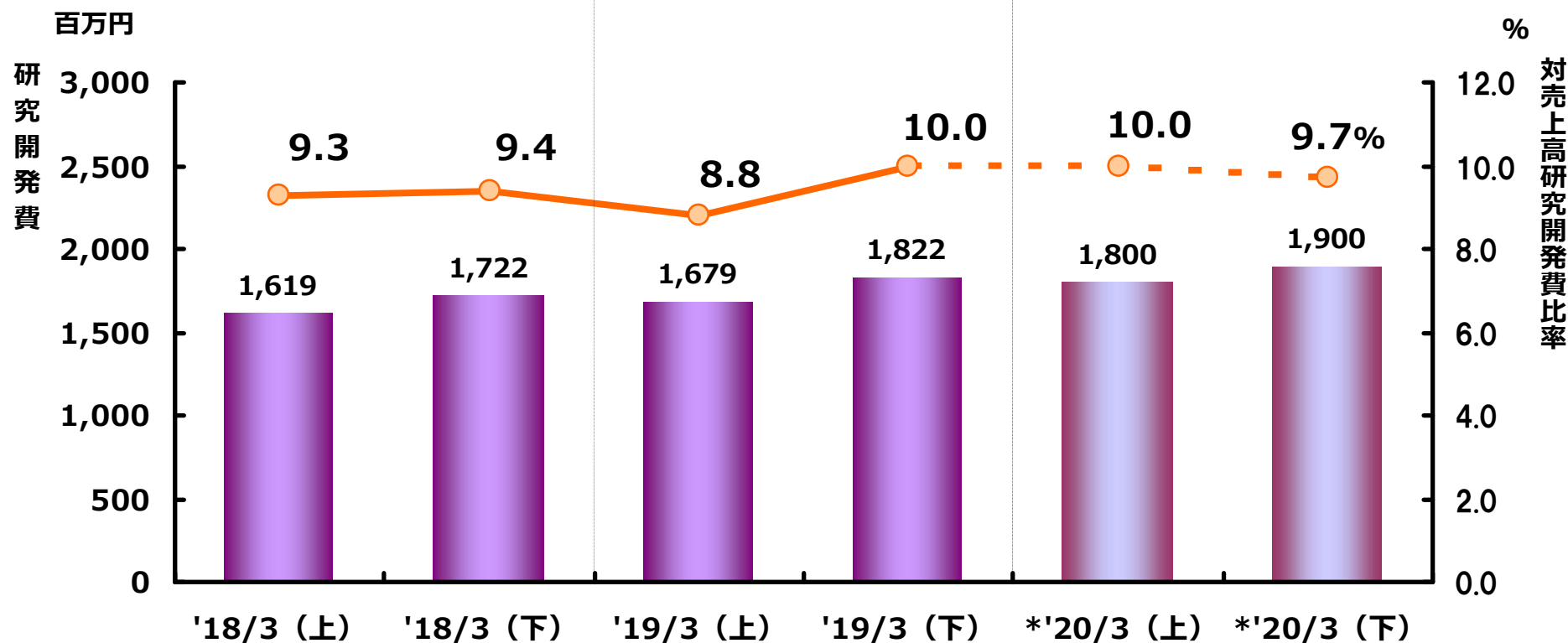
単位：百万円	18年3月期	19年3月期			20年3月期		
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比	通期計画	前年比
研究開発費	3,342	3,500	3,501	+4.8%	+0.0%	3,700	+5.7%





# 研究開発費／売上高比（半期実績・半期計画）

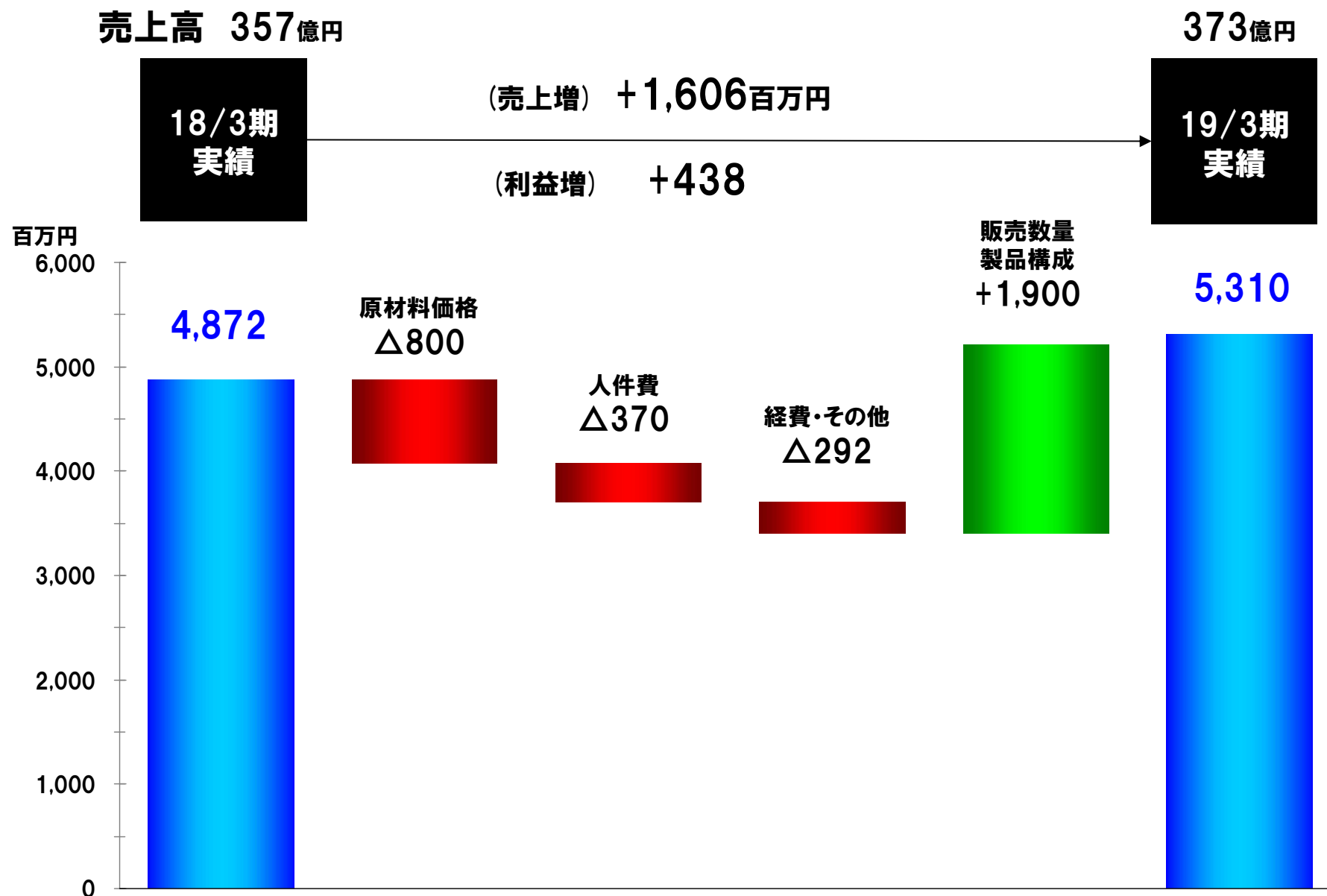
単位：百万円	18年3月期		19年3月期				20年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	上期比
研究開発費	1,619	1,722	1,679	1,822	+5.8%	+8.5%	1,800	+7.2%	△1.2%	1,900	+4.3%	+5.6%



## 4. 損益分析

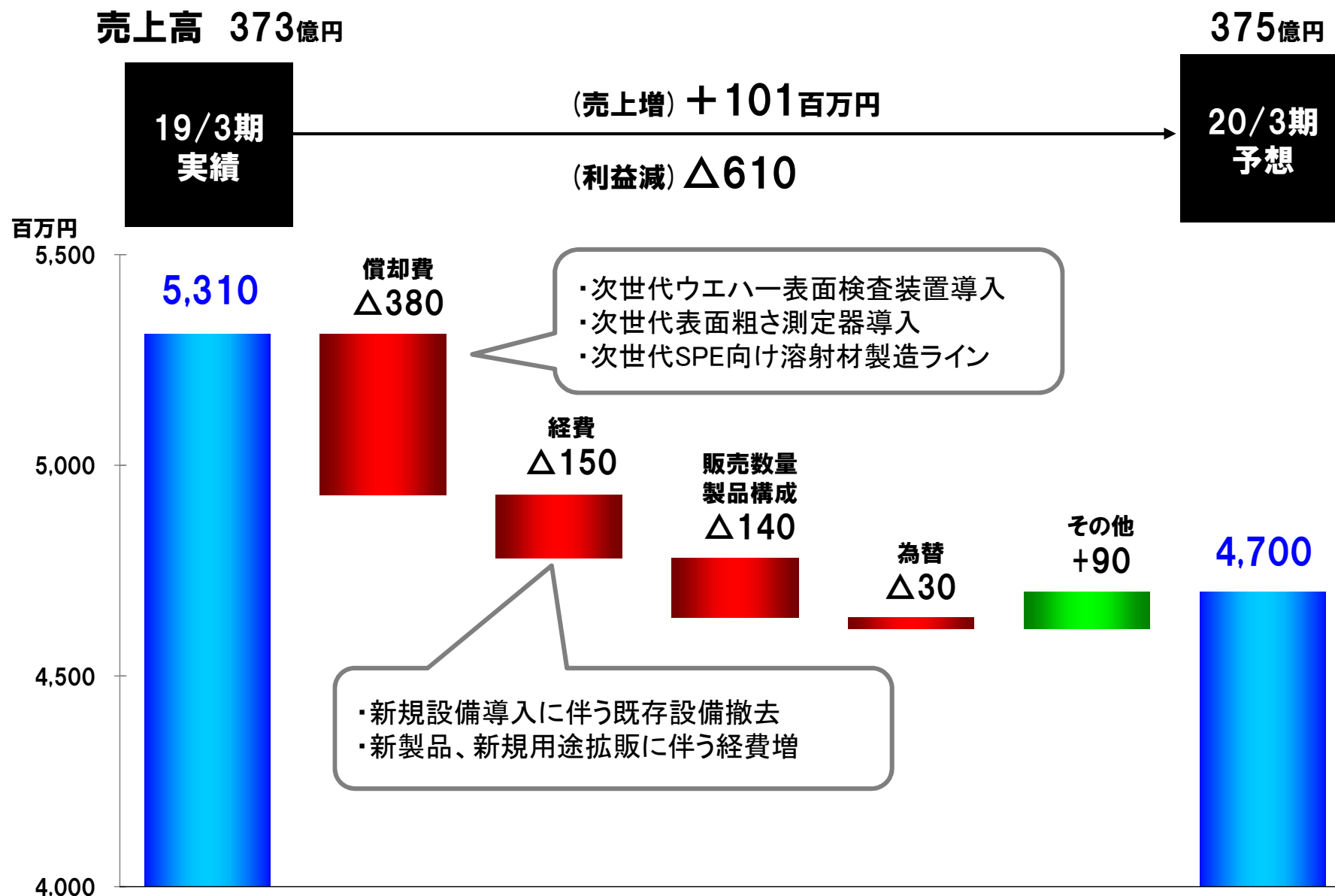
# 営業利益増減要因

18/3期実績→19/3期実績



# 営業利益増減要因

19/3期実績→20/3期予想



## 5. 株主還元

# 積極的な株主還元と安定配当の継続

## ■ 利益配分に関する基本方針

1. 連結配当性向 50%以上
2. 安定配当の継続

・現在の業績水準では1株当たり80円

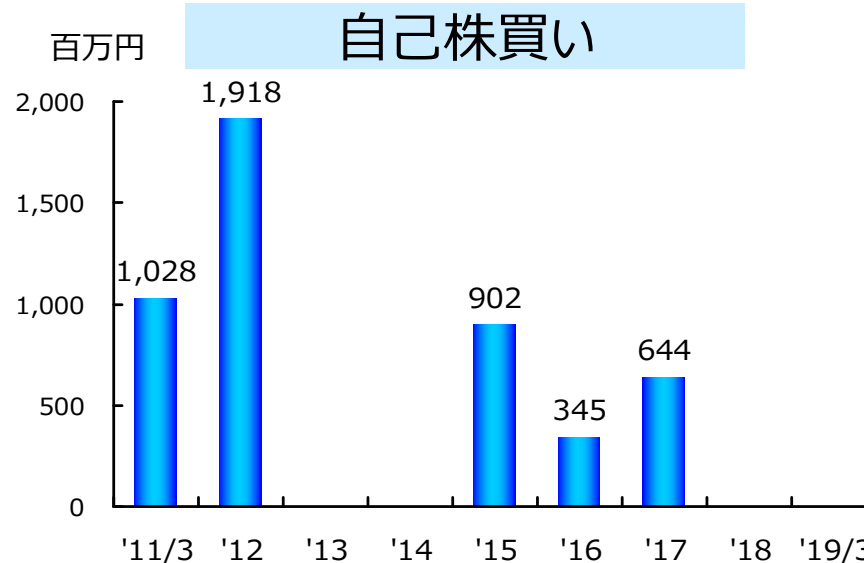
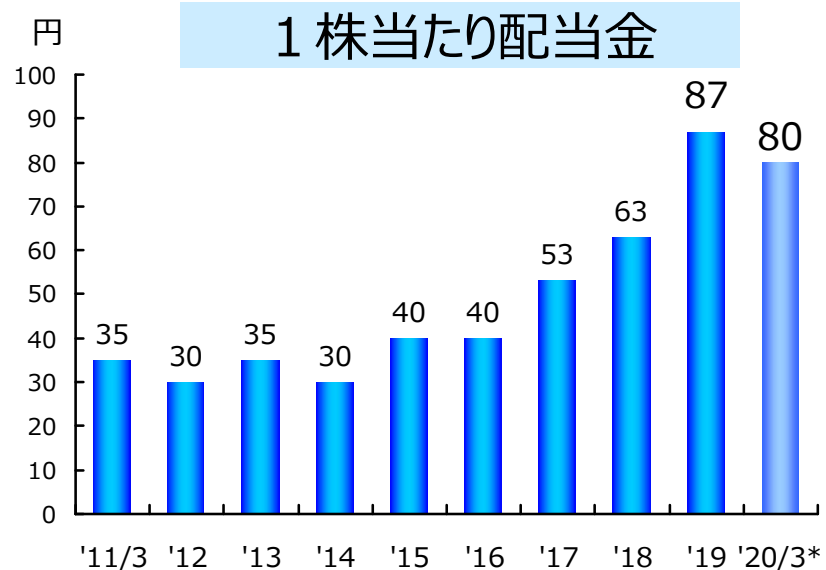
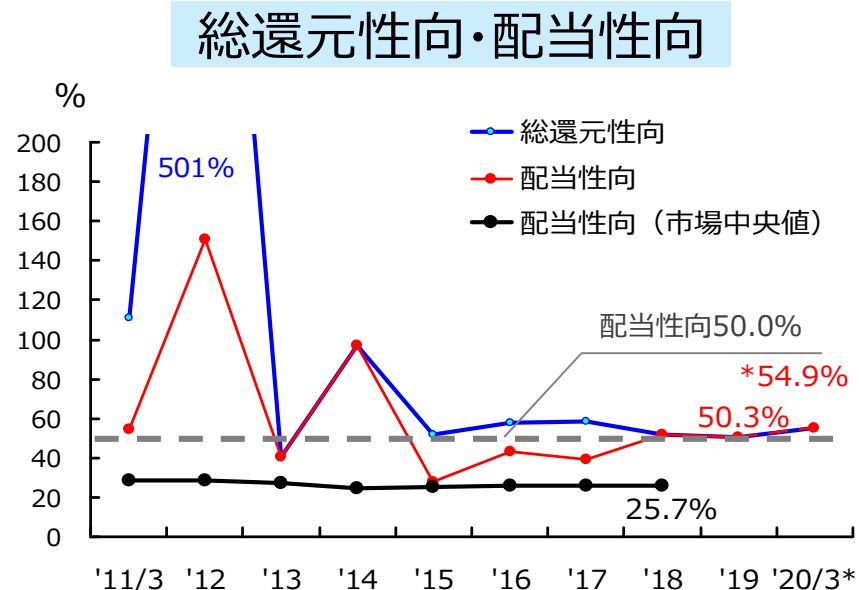
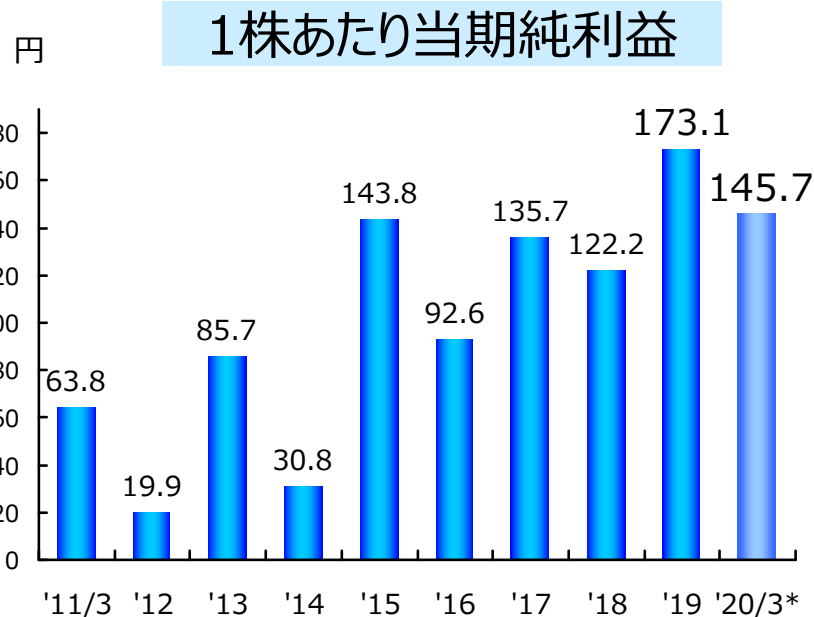
## ■ 1株当たり配当金

	2019/3月期		2020/3月期	
	期初予想 2018/5/11	修正予想 2018/11/2	実績 2019/5/10	期初予想 2019/5/10
中間配当金	40円 (予想)	40円 (実績)	40円 (実績)	40円 (予想)
期末配当金	40円 (予想)	45円 (予想)	47円 (実績)	40円 (予想)
年間配当金	80円 (予想)	85円 (予想)	87円 (実績)	80円 (予想)
配当性向	50.6% (予想)	49.9%* (予想)	<b>50.3%</b> (実績)	<b>54.9%</b> (予想)

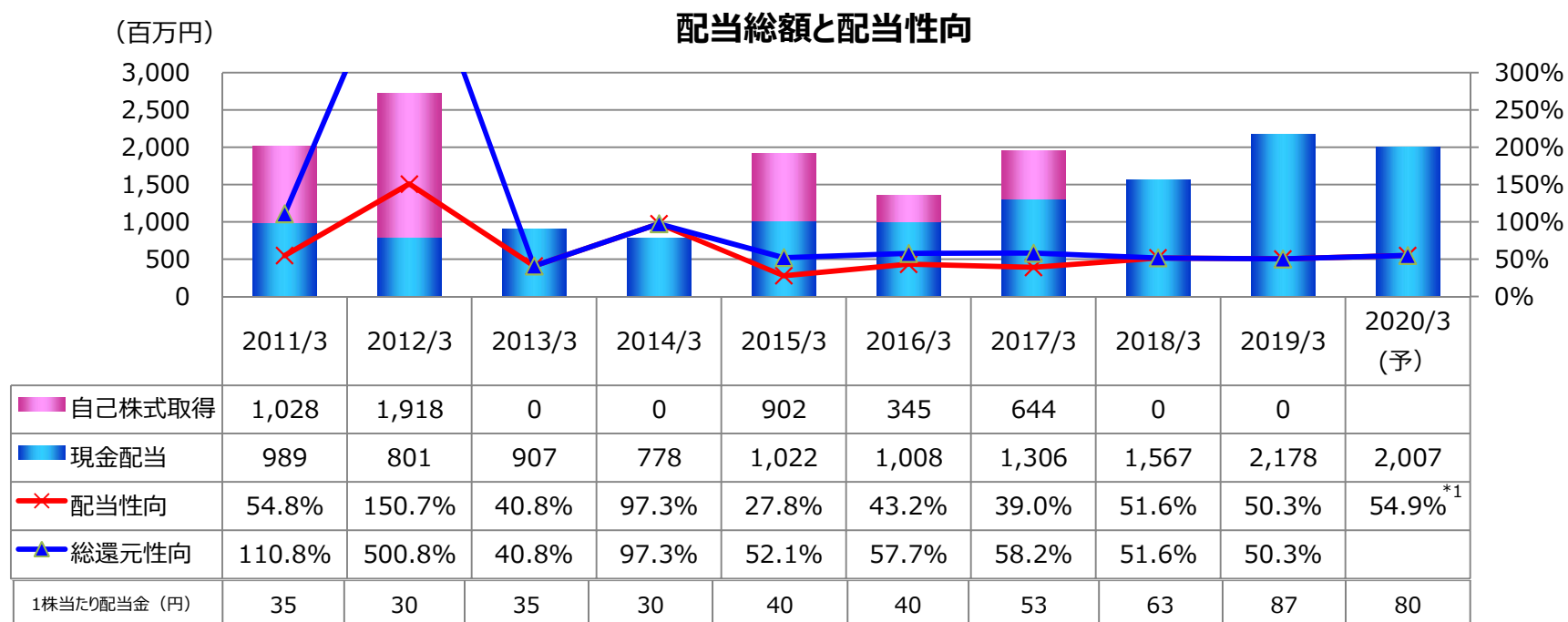
\*当期純利益を実績(4,265百万円)とした場合 **49.1%**

**前期期初予想と同額**

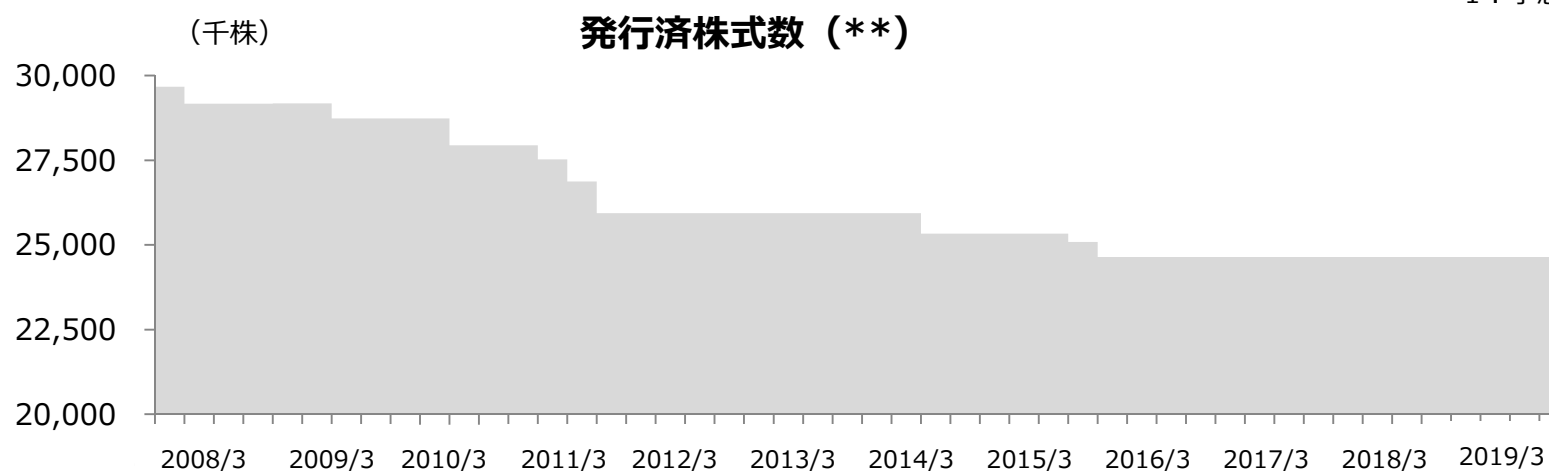
# 積極的な株主還元と安定配当の継続



# 積極的な株主還元と安定配当の継続



\*1：予想



\*\*自己株式は除く

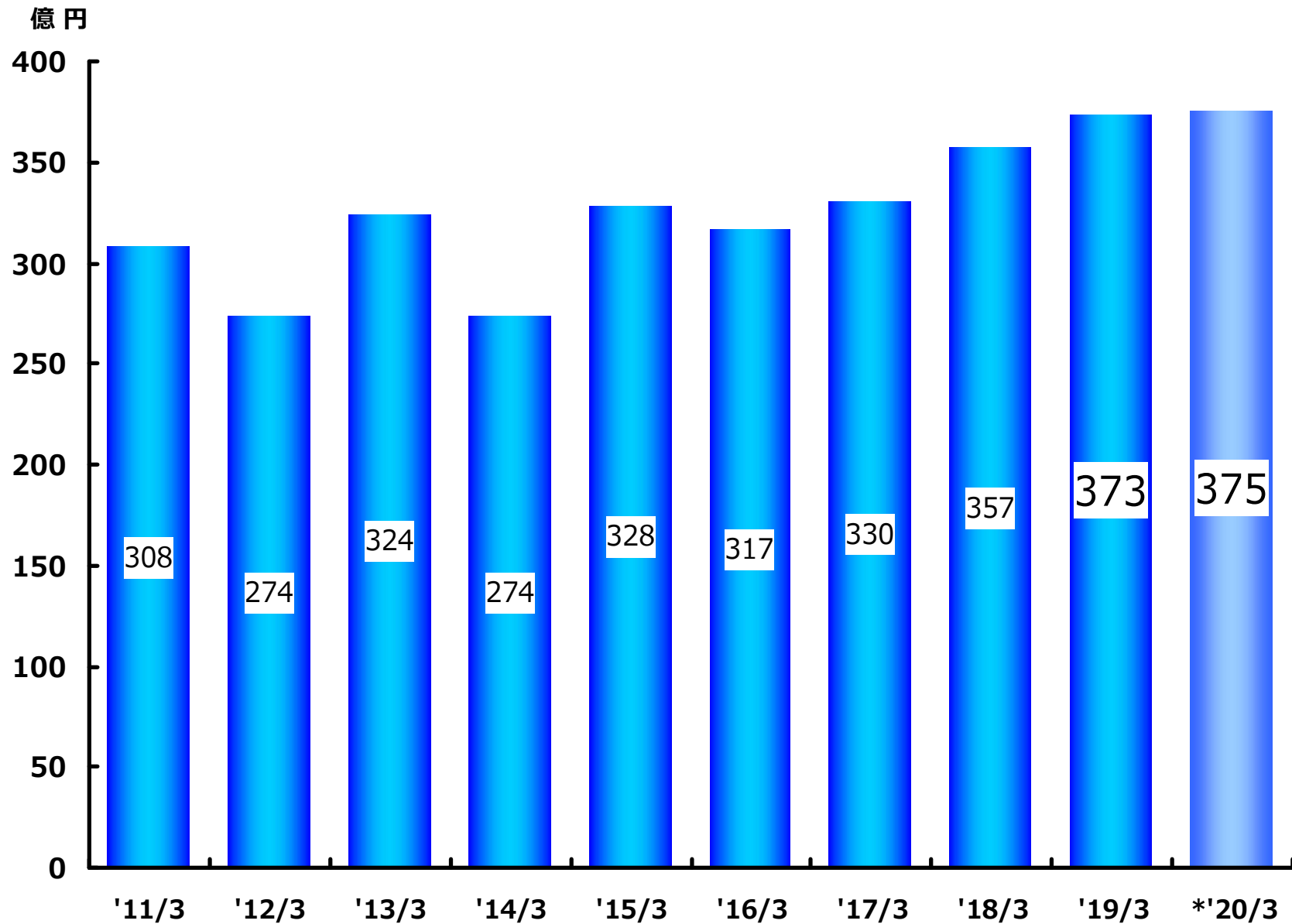


# 補足データ資料

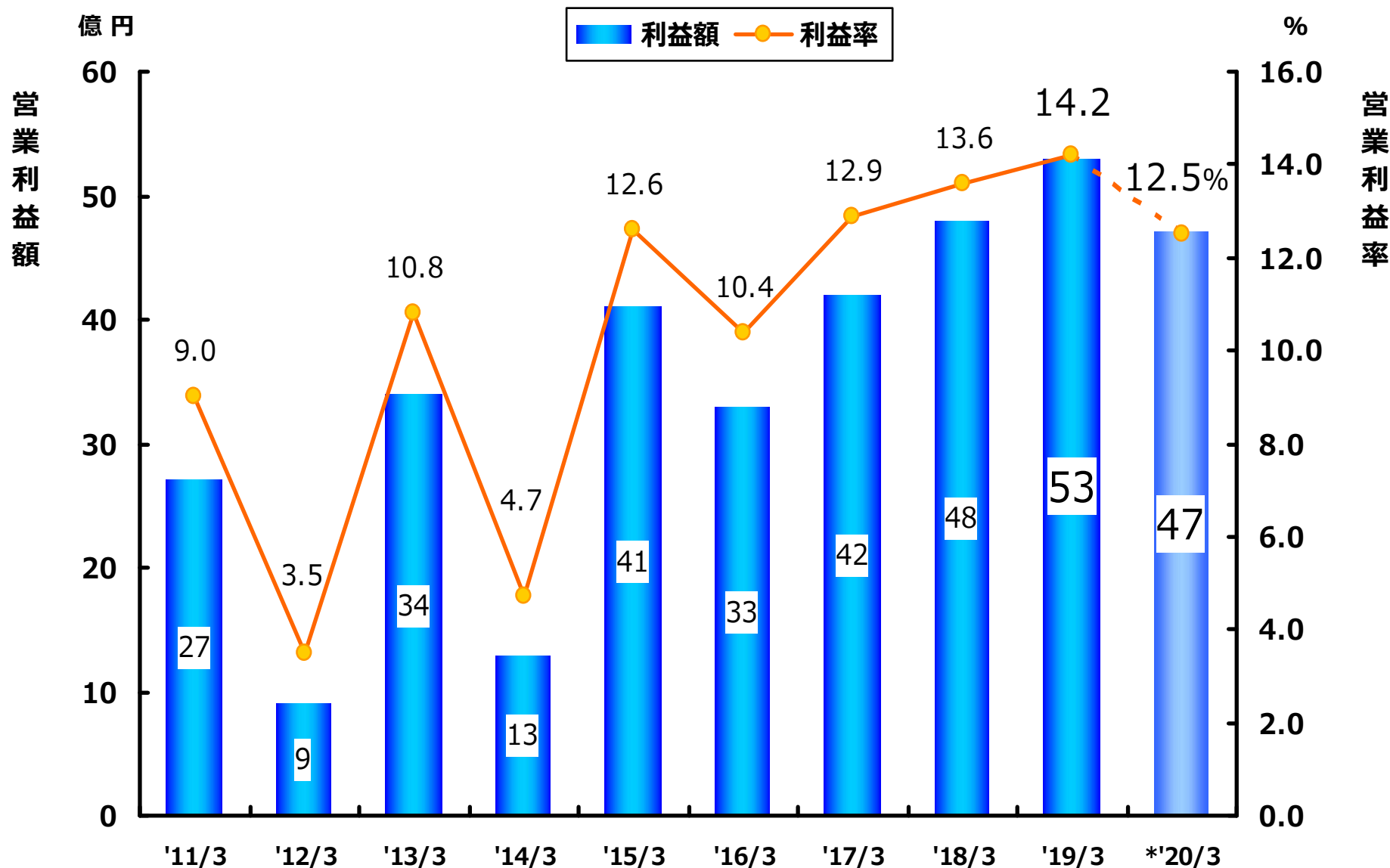
# グループ人員 内訳

(人数)	18年3月期 (3月31日現在)		19年3月期 (3月31日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 *	正社員	臨時 雇用者 *	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	580	173	588	193	+8	+20
フジミコーポレーション	111	3	114	3	+3	—
フジミ台湾	73	0	77	1	+4	+1
フジミマイクロテクノロジー	65	8	66	7	+1	△1
フジミヨーロッパ	4	2	5	1	+1	△1
フジミ韓国	5	0	6	0	+1	—
フジミ深圳	6	0	5	1	△1	+1
合 計	844	186	861	206	+17	+20

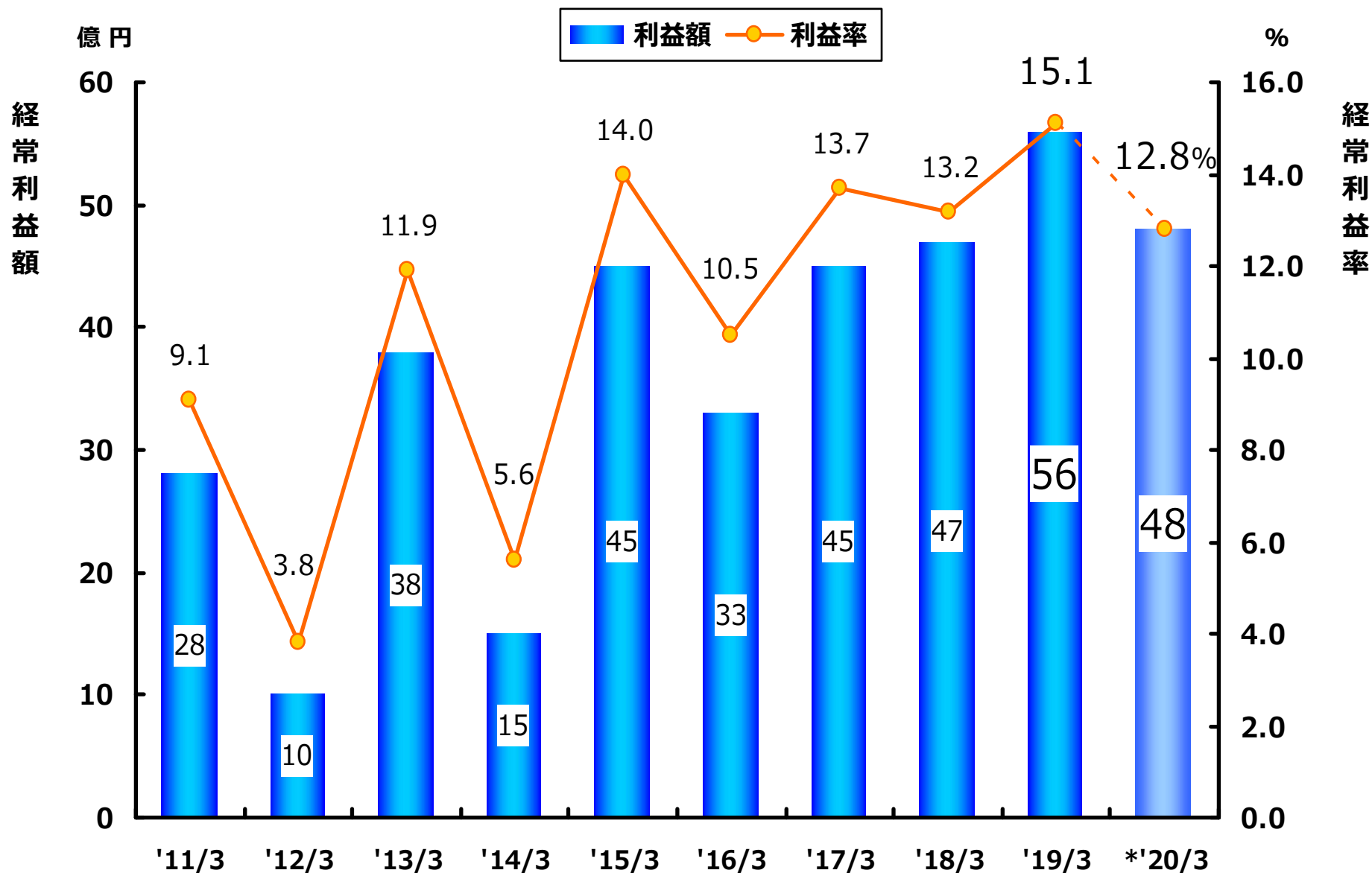
# 売上高 (通期)



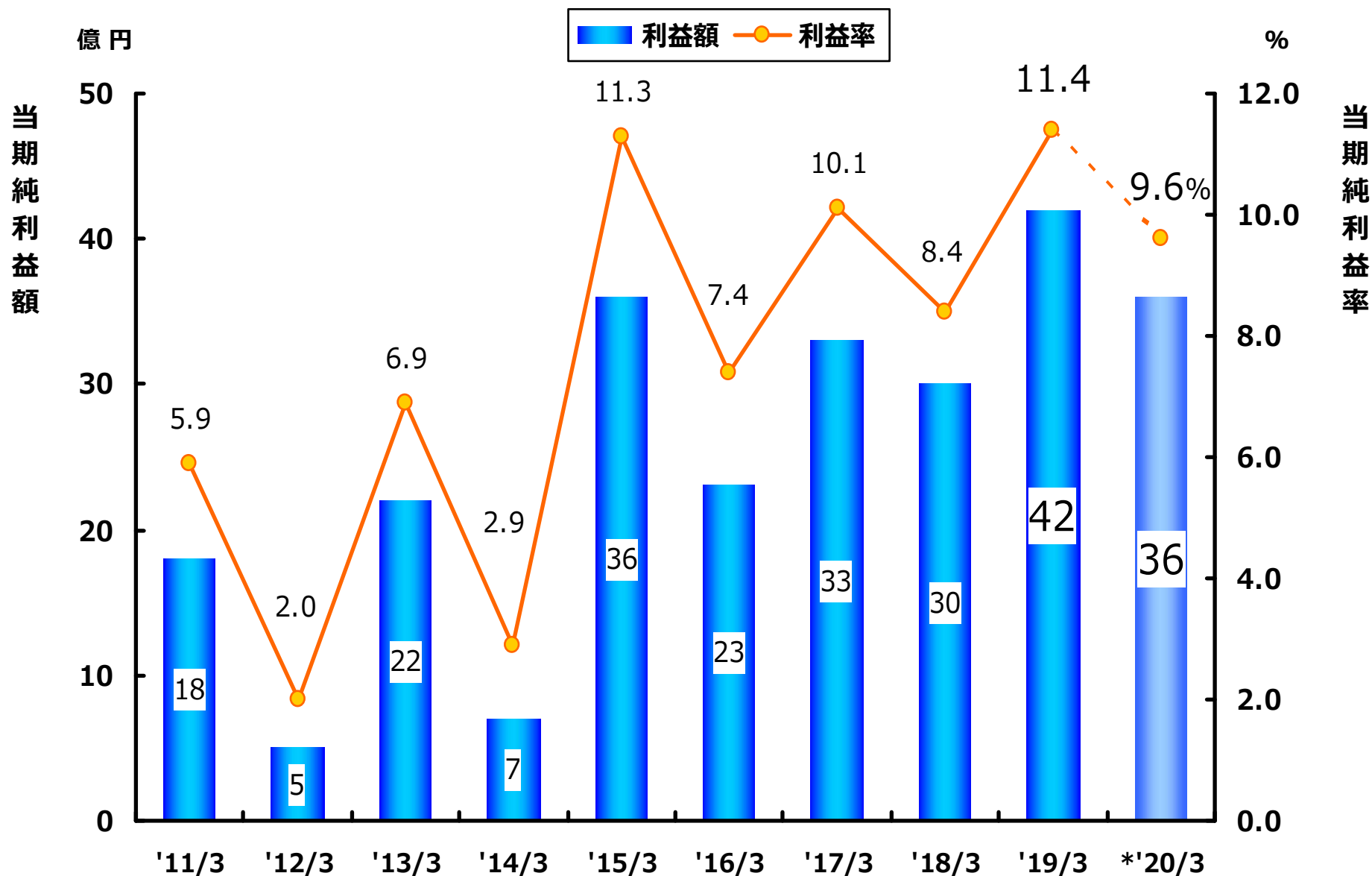
# 営業利益 (通期)



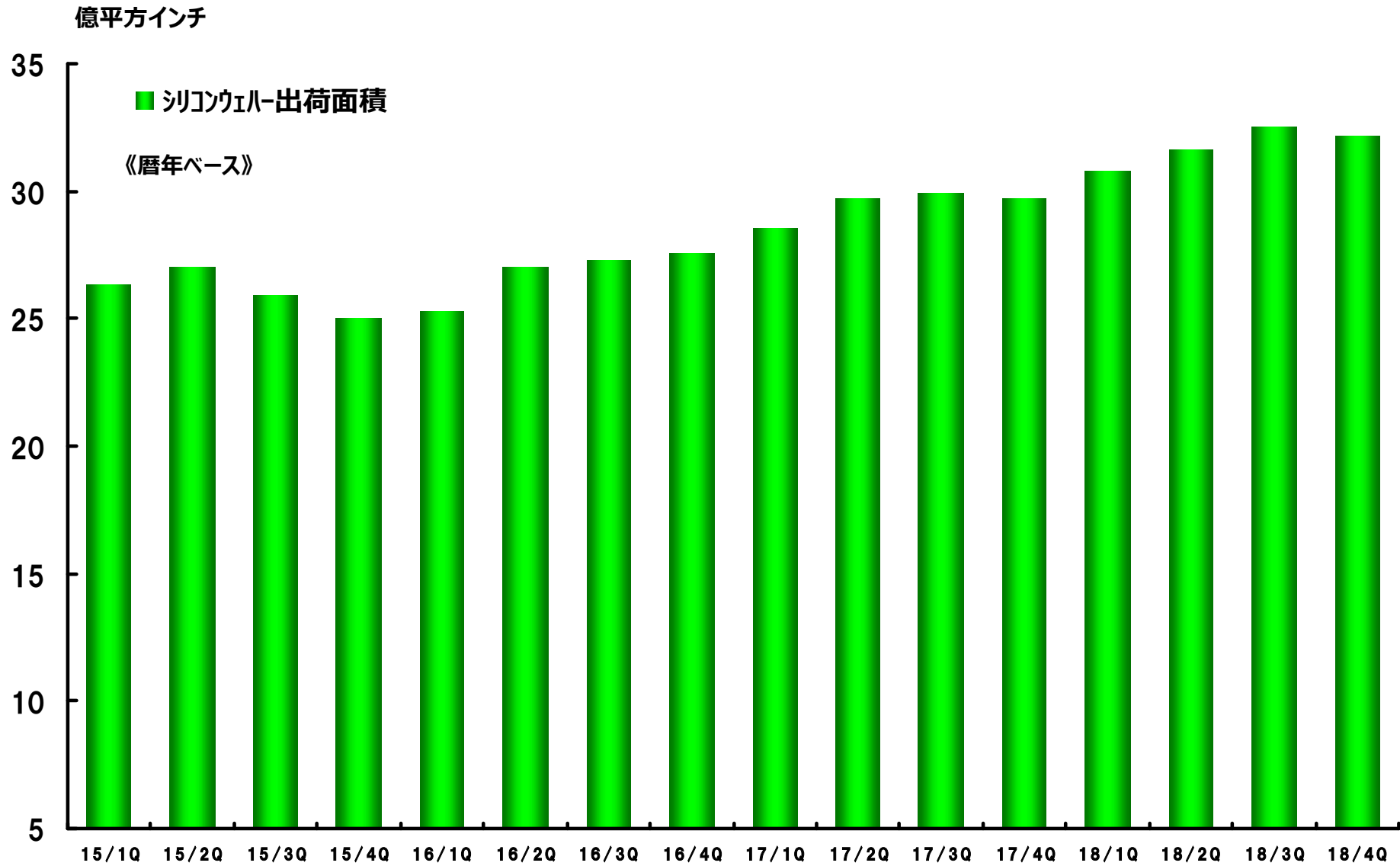
# 経常利益 (通期)



# 当期純利益 (通期)



# シリコンウェハー出荷面積 (四半期)



出所: SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

# 半導体市場規模（地域別）

(単位：億ドル)

